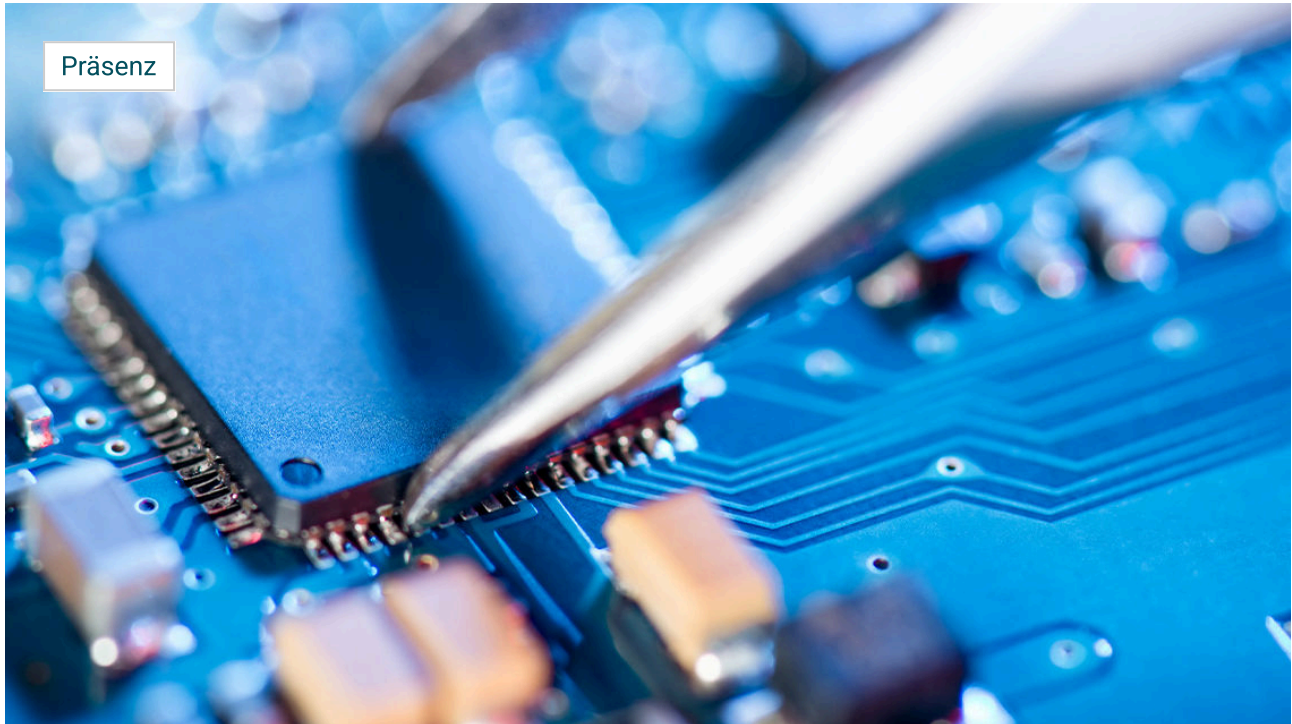


Konstruieren von mechatronischen Produkten

Die optimale Integration von Elektroniktechnologien in Gehäusen



Termin

Di. 29.04.2025, 09:00 Uhr –
Mi. 30.04.2025, 16:00 Uhr

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 1.250,00 €*
[Für HDT-Mitglieder](#) 1.125,00 €*

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.
Hollestr. 1
45127 Essen



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Buchung **Ihrer Teilnahme finden Sie auf der [Veranstaltungs-Webseite](#).**

Stand: 01.05.2025, 03:01 Uhr

Konstruieren von mechatronischen Produkten

Das Seminar vermittelt zuerst das Verständnis für die verschiedenen Elektronik-Technologien. Die Kenntnis ist wichtig für das gemeinsame Verständnis im Entwicklungsteam zusammen mit dem Elektronikentwickler. Danach wird die normenkonforme Befestigung der starren Leiterplatte besprochen. Es folgt die Vermittlung von Wissen über Anschlussstechnik, also Klemmen, Steckverbinder sowie Litzen und Kabel im und außerhalb des Gehäuses. Je nachdem, wo das Gehäuse zum Einsatz kommt, muss es einen Schutz gegenüber Staub oder Feuchtigkeit aufweisen. Und zum Schluss wird die Entwärmung von elektrischen Baugruppen behandelt. Sie schützt heiße Bauteile vor dem Versagen und sichert so einen optimalen Kundennutzen.

Zum Thema

Der Konstrukteur in der Elektronikentwicklung hat zwei Seiten zu beachten: die mechanische und die elektrische. Er hat die mechanische Befestigung, Dichtigkeit und ggfs. Entwärmung in seinem Gehäuse im Blick. Dabei bedient er sich seinem Wissen aus seiner mechanischen Ausbildung/Studium. Leider stößt er dabei an seine Grenzen, denn der Umgang und die Integration mit Elektronik ist neues Fachgebiet. Dieses Seminar hilft ihm, den vielfach unbekanntem Bereich Elektrik/Elektronik aus seiner Sicht zu verstehen und seinen Handlungsspielraum zu lernen.

Zielsetzung

Lernen Sie das Handwerkszeug als Elektronikonstrukteur, damit Sie sich mit allen Elektroniktechnologien auskennen und sie optimal im Gehäuse unterbringen können. Statt Schaltpläne zu erstellen, lernen Sie im Seminar die verschiedenen Elektronik-Technologien (u.a. starr, flex, MID, Additiv) aus der Sicht des Mechanik-Entwicklers kennen. Im richtigen Fachjargon werden Techniken wie Konstruieren mit Luft- und Kriechstrecken, Elektronikbefestigung, Anschlussstechnik, Dichtigkeit und Entwärmung verwendet.

Programm

29.04.2025

09:00–09:15 Begrüßung

09:15–10:30 Gehäusekonstruktion und Grundlagen Elektronik

10:30–10:45 Kaffeepause

10:45–12:30 Gehäusekonstruktion und Grundlagen Elektronik (Fortsetzung)

12:30–13:30 Mittagspause

13:30–15:00 Leiterplattenbefestigung

15:00–15:15 Kaffeepause

15:15–17:00 Leiterplattenbefestigung (Fortsetzung)

30.04.2025

09:00–09:30 Rückblick erster Tag

09:30–10:30 Anschlusstechnik

10:30–10:45 Kaffeepause

10:45–12:30 Anschlusstechnik (Fortsetzung)

12:30–13:30 Mittagspause

13:30–15:00 Dichtigkeit und Entwärmung

15:00–15:15 Kaffeepause

15:15–16:00 Dichtigkeit und Entwärmung (Fortsetzung)
